Моделирование технологических процессов Лекция 5

Вопросы к экзамену

- 1. Особенности процесса постимплантационной диффузии. TED-эффект.
- Термическое окисление кремния. Модель Дила-Гроува.
- Допущения при выводе модели Дила-Гроува. Константы линейного и параболического роста.
- Основные этапы численного моделирования процесса окисления. Модель Массуда для начального этапа процесса окисления.

Особенности процесса постимплантационной диффузии. ТЕД-эффект

Формирование очень мелких, менее 40 нм, легированных слоев в кремнии с высокой концентрацией электрически активной примеси и профилем распределения примеси, близким к прямоугольному, стало значительным достижением в интегральной технологии

Однако с уменьшением размеров требуются все более мелкие области с все более низким сопротивлением. Создание таких слоев без введения дефектов в кремний и без влияния материалов других слоев почти невозможно

В процессе ионной имплантации создается большое число дефектов в подложке, что сильно влияет на процесс постимплантационного отжига.

Высокие дозы имплантации приводят к аморфизации поверхности кремния и формированию распределенных дефектов, дислокаций (линейных дефектов кристаллической решетки, «лишних» полуплоскостей).

Временно ускоренная диффузия, или ТЕD-эффект

Экспериментально обнаружено, что существует временной интервал, в процессе постимплантационного отжига, когда диффузия идет с существенно более высокой скоростью, примерно постоянной в течение этого интервала. Затем скорость диффузии падает до обычного значения.

Длительность временного интервала ускоренной диффузии падает с ростом температуры отжига.

В результате при исследовании быстрого постимплантационного отжига может возникать аномальный эффект: при более высокой температуре отжига могут наблюдаться меньшие глубины p-n переходов.

Этот эффект получил название эффект временно-ускоренной диффузии или *TED-эффект*.

ТЕD-эффект объясняется ускорением диффузии за счет неравновесной концентрации междоузлий, которые отжигаются более быстро при высокой температуре.

Моделирование ТЕD – эффекта

Построение эксперимента для моделирования ТЕО – эффекта:

- •Использовались подложки с ориентацией <100> 10-15 Омсм р- и п-типа.
- •Методом эпитаксиального наращивания создавался маркирующий слой толщиной 0.2 мкм и концентрацией бора 1х10¹⁸см⁻³.
- •Выращивался слой нелегированного кремния толщиной 0.4 мкм.
- •Имплантация ионов фосфора, мышьяка или кремния с энергией 50 КэВ и дозами в диапазоне 1х10¹³ 1х10¹⁵ см⁻².
- •Одна подложка оставалась в качестве контрольного образца нелегированной.
- •Полученные образцы отжигались при температуре 750С в течение различных периодов времени, часть образцов оставлены не отожженными.





Модели, задействованные при расчете ТЕD-эффекта

- +1 модель
- Дислокационные кольца
- Модель кластеризации междоузлий

Постимплантационные дефекты +1 модель

Имплантирумый атом создает траекторию разрушений, соударяясь с атомами решетки и смещая их, создавая междоузлия и вакансии. Каждый имплантированный ион может создавать порядка 100 междоузлий (I) и вакансий (V), прежде чем он остановится.

Считается, что, хотя полное количество постимплантационных дефектов значительно выше, каждый ион в результате имплантации смещает в среднем 1 атом из решетки, причем распределение междоузлий смещено в глубину подложки, а вакансий - к поверхности.

Расчетные зависимости концентрации вакансии и междоузлий после имплантации: — I, V; [V-I]



Окончательным результатом имплантации является распределение всех ионов по узлам решетки, в результате чего каждый ион смещает один атом решетки в междоузлие.

Прямые имплантационные разрушения вдоль траектории иона исчезают в результате рекомбинации I-V – пар за время сравнимое с коротким периодом TED процесса

Моделирование методом Монте-Карло



Кольца дислокаций

Для случая аморфизирующей имплантации известно о формировании протяженных дефектов на границе между аморфизированной и кристаллической областями.

Эти протяженные дефекты известны как кольца дислокаций.

При моделировании дислокационные кольца считаются имеющими одинаковый радиус и плотность и оцениваются по результатам исследований с помощью просвечивающей электронной микроскопии. Расположение колец определяется по глубине аморфного слоя.

Аморфизация кремния



Имплантация As+ 60 КэВ, 5e15 см⁻²

Кластеризация точечных дефектов

Согласно экспериментальным исследованиям междоузлия группируются в плоскости {311}.

Найдено, что эти кластеры диссоциируют во время отжига и скорость диссоциации экспоненциально падает. Поэтому за короткое время только часть имплантированных дефектов способна внести вклад в TED-эффект.

Если время увеличивается, то число высвобождаемых дефектов возрастает, и вклад в TED – эффект увеличивается.

Если отжиг идет при высокой температуре, большинство кластеров активно диссоциируют в процессе роста температуры. Поэтому должен быть произведен тщательный учет диссоциации кластеров при моделировании подъема температуры в процессе отжига

Быстрый термический отжиг для создания сверхмелких р-п переходов



Вид временной диаграммы

Зависимость максимальной концентрации электрически активного бора в p+- слое от положения точки перегиба Х

Теоретические основы процесса окисления кремния

- Модель Дила-Гроува рассматривает процесс термического окисления кремния, как состоящий из двух этапов
 - массопереноса окислителя в растущем окисле
 - протекания химической реакции кремния с окислителем.

Модель включает три потока

 $F_1 = h(C^*-C_0) - массоперенос через внешнюю границу окисла, <math>C^*, C_0 -$ концентрации окисляющих частиц;

 $F_2 = D(C_0 - C_i)/x - диффузия$ окислителя через окисел к границе раздела окисел/кремний.

F₃ = kC_i – химическая реакция на границе раздела окисел/кремний.



 $F_2 = F_3 : C_i = C_0 / (1 + kx/D)$ $F_1 = F_3 : C_i = C^* / (1 + k/h + kx/D)$ $dx/dt = F_3 / N$ 14

В условиях равновесия $F_1 = F_2 = F_3$

Зависимость толщины окисла кремния от времени при термическом окислении

$$\frac{dx}{dt} = \frac{kC^* / N}{1 + \frac{k}{h} + \frac{kx}{D}}$$

$$B = 2DC^* / N \qquad \qquad A = 2D\left(\frac{1}{k} + \frac{1}{h}\right)$$

N – число частиц окислителя, необходимое для создания единицы объема окисла

$$\frac{dx}{dt} = \frac{B}{A+2x}$$

k_p = В и k_L = В/А – константы параболического и линейного роста



После интегрирования $x^{2} + Ax = B(t+t_{0})$ $\frac{x^{2} - x_{0}^{2}}{k_{P}} + \frac{x - x_{0}}{k_{L}} = t - t_{0}$

Допущения, лежащие в основе модели Дила –

Гроува

- Для первого этапа адсорбции окислителя на внешней поверхности слоя SiO₂ предполагается, что молекулы O₂ не диссоциируют.
- В этом случае справедлив закон Генри С*~ Р.
- В случае полной диссоциации $C^* \sim P^{0.5}$ для реакции $O_2 \leftrightarrow 2O$.
- В настоящее время состояние молекул кислорода в момент адсорбции и заряд частиц окислителя окончательно не выявлены

Допущения, лежащие в основе модели Дила – Гроува (продолжение)

- На этапе диффузии окислителя к поверхности кремния теоретически возможен и обратный процесс.
- Эксперименты показывают, что вероятность обратного процесса – диффузии кремния через пленку окисла навстречу кислороду ничтожно мала.
- Неясно, в каком точно виде диффундирует окислитель.
- Наиболее вероятное предположение диффузия O₂⁻ по междоузлиям оксида без взаимодействия с кислородом решетки
- Уравнение для потока F₂, описывающее процесс диффузии, является упрощенным представлением диффузионного уравнения

Допущения, лежащие в основе модели Дила – Гроува (продолжение)

- Относительно химической реакции на границе Si - SiO₂: считается, что ее порядок равен единице.
- Изменение внутренней структуры образующегося окисла не учитывается.
- Экспериментальные данные говорят о том, что в приграничной области имеются механические напряжения и идет генерация дефектов, что обязательно влияет на скорость протекающей химической реакции

Допущения, лежащие в основе модели Дила – Гроува (продолжение)

- Неявно присутствуют следующие допущения:
- процессы переноса и протекание химической реакции рассматриваются отдельно и независимо друг от друга;
- наличие растворенного в кремнии кислорода считается не существенным;
- - все процессы считаются квазистационарными, т.е. $\partial C / \partial t = 0$

Константы линейного и параболического роста

уравнение Дила-Гроува, описывающее рост окисла

 $\frac{x^2 - x_0^2}{k_P} + \frac{x - x_0}{k_L} = t - t_0 \quad k_P \text{ и } k_L - \text{ константы} \\ параболического и линейного \\ роста$

k_p определяет диффузию окислителя через пленку,

k_L определяет скорость химической реакции на границе раздела

Факторы, влияющие на значение констант линейного и параболического роста

температура: константа параболического роста В и константа линейного роста В/А зависят от температуры по закону Аррениуса.

$$k_{p} = k_{p0} \exp[-E_{p}/kT],$$

$$k_{L} = k_{L0} \exp[-E_{L}/kT].$$

-парциальное давление окислителя

 k_p от парциального давления зависит линейно, по закону Генри $k_p \sim p$; $k_L \sim p^n$; n=0.5 ÷ 1.0 в зависимости от температуры и окислительной среды.

наличие примеси в атмосфере: вода, натрий, хлор ускоряют окисление.

ориентация подложки: на k_р практически не влияет;

 $k_{L}(111) > k_{L}(110) > k_{L}(100).$

Основные процессы, учитываемые при

численном моделировании окисления

Точное моделирование окисления и других термических операций, которые изменяют состав и структуру слоев должно включать моделирование следующих процессов:

- химические реакции на границах раздела слоев, состоящие из растворения частиц, реакции частиц с материалом слоя,
- образование нового слоя;

- диффузия примеси;
- сегрегация примеси на границах раздела слоев;

Основные процессы, учитываемые при численном моделировании окисления

Основные процессы, учитываемые при численном моделировании окисления

экранирование потоков частиц слоями и границами раздела;

 механическая деформация слоевой структуры как результат протекания химических реакций.

Расчет окислительного процесса

- решение уравнения растворения диффузии – химической реакции для частиц окислителя,
- т.е. расчет процесса диффузии частиц окислителя с граничными условиями на границах раздела в виде уравнений химических реакций/растворения;

Расчет окислительного процесса

- оценка скоростей образования и поглощения на границе раздела и определение граничных условий для расчета механических напряжений;
- - расчет механических напряжений;

Расчет окислительного процесса

- вычисление граничных условий и решение уравнения диффузии примеси;
- расчет изменения толщин слоев;
- локальное обновление сетки в окрестности движущихся границ раздела,
- интерполяция концентраций,
- если необходимо, полное обновление сетки.

Модель Массуда

 Позволяет с более высокой точностью моделировать ускоренный начальный этап окисления за счет введения дополнительных параметров С и L, определяющих начальный этап роста окисла

$$\frac{dx_{ox}}{dt} = \frac{B}{2x_{ox} + A} + C \exp\left(-\frac{x_{ox}}{L}\right)$$

В присутствии N₂O (оксинитридизация) скорость роста снижается

$$r_{thin} = C \exp\left(-\frac{x_{ox}}{L}\right) \left(1 - \frac{\sigma_N}{\sigma_{max}}\right)$$

Моделирование окисления в программе Sprocess.

- Используются три реагента кислород, пары воды и N₂O.
- Основной моделью, устанавливаемой по умолчанию при расчете скорости роста окисла в одномерном случае, является модель Массуда
- Константы А, В, С, L определяются в зависимости от парциального давления окислительных реагентов, в общем случае для смешанной окислительной атмосферы произвольного состава

Константа параболического роста

$$B(T) = \begin{cases} B0.h \cdot \exp\left(-\frac{BW.h}{k_BT}\right), \text{ if } T > BT.break \\ B0.l \cdot \exp\left(-\frac{BW.l}{k_BT}\right), \text{ else} \end{cases}$$

$$B = B(p, T) = B(T)p_{Comp}^{\text{Bp.dep/[bar]}}$$

Oxide H20 | 02 | N2O.

Константа линейного роста

$$\frac{B}{A}(T) = \begin{cases} BA0.h \cdot \exp\left(-\frac{BAW.h}{k_BT}\right), \text{ if } T > BAT.break \\ BA0.1 \cdot \exp\left(-\frac{BAW.1}{k_BT}\right), \text{ else} \end{cases}$$

Oxide_Silicon	H20	02	N20 100	110	100
Oxide_PolySilicon	H20	02	N20 100	110	100

Параметры модели Массуда

$$C(T) = \begin{cases} \text{CO.h} \cdot \exp\left(-\frac{\text{CW.h}}{k_B T}\right), \text{ if } T > \text{MBAT.break} \\ \text{CO.l} \cdot \exp\left(-\frac{\text{CW.l}}{k_B T}\right), \text{ else} \end{cases}$$

$$L(T) = \begin{cases} \text{L0.h} \cdot \exp\left(-\frac{\text{LW.h}}{k_B T}\right), \text{ if } T > \text{MBAT.break} \\ \text{L0.l} \cdot \exp\left(-\frac{\text{LW.l}}{k_B T}\right), \text{ else} \end{cases}$$

Зависят от температуры и ориентации подложки

Oxide_Silicon O2 | H2O | N2O 100 | 110 | 111 Oxide_PolySilicon O2 | H2O | N2O 100 | 110 | 111